

Siconnex BATCHSPRAY® Acid: Effizienz hat einen Namen.



Die Siconnex BATCHSPRAY® Acid ist für Säuren und Basen konzipiert. Sie kann manuell beladen oder mit Siconnex BATCHSPRAY® Autoload kombiniert werden. Die Anlage ist ein komplett geschlossenes System, somit ist der Operator geschützt vor direktem Kontakt mit Chemikalien. Der Prozessvorgang ist dadurch sicher und darüber hinaus umweltschonend. Die Siconnex BATCHSPRAY® Acid kann Wafergrößen von 50 mm bis 300 mm prozessieren.



VORTEILE

- Automatisierter Trocken-zu-Trocken-Prozess
- Fünf Prozesse in einer Sequenz möglich
- Wiederholbarkeit durch Prozessregelung
- Stellfläche 1.2 m x 2 m
- bis zu 80 % weniger DI Wasser
- bis zu 80 % weniger Medienverbrauch
- Abgeschlossenes System
- Benutzersicher
- Chemiemischungsmanagementsystem



BATCHSPRAY®
ACID

ETCH

- Metal Etch (Al, Cu, Ti, Au, Ni,...)
with End Point Detection
- III/V Etch (GaAs, AlGaAs, InGaP,...)
- Oxide Etch
- Freckle Etch
- Silicon Etch
- Ge Etch
- Nitride Etch
- UBM Etch
- Glass Etch

CLEAN

- SicOzone™ Clean
- SicOzone™ + Ultra Diluted Clean Applications
- Contact Cleans
- Organic Removal & Clean
- Etch Residue Clean
- Post Ash Residue Clean
- HF Last
- Prediffusion Cleans
- Field Cleans (Organic & Inorganic Cleans)

RESIST STRIP

- SicOzone™ Strip
- Positive and Negative Resist Strip
- Implanted Photo Resist Strip
- Enhanced Strip
- Resist Rework

DER SICOZONE™-PROZESS

- Reinigt und löst Lack von Substraten.
- Keine teuren, gesundheitsschädlichen Lösemittel notwendig.
- Ozon aus Sauerstoff ist in der Herstellung günstig.